

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

半導体装置は、内部に形成された半導体回路と第1の表面に形成された電極構造とを含み、前記電極構造は、第1の金属で形成され前記半導体回路に接続された第1の電極層と、前記第1の電極層の上に第2の金属で形成された金属メッキ層と、を有し、前記第2の金属は、半導体装置の外部における取り出し電極とはんだ付け可能である。